

- [5] Jones G.A., Lacey T.M., Rushchalska I.B. // Journ. Appl. Phys. 1982. V. 53(11). P. 7870-7872.
- [6] Гудинаф Дж. В сб.: Магнитная структура ферромагнетиков. М.: ИЛ, 1959, с. 58.
- [7] Семенцов Д.И. // Кристаллография. 1981. Т. 26. С. 753-757.
- [8] Зубков Ю.Н. // ЖТФ. 1983. Т. 53. С. 2278-2280.

Калининский государственный  
университет

Поступило в Редакцию  
8 февраля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 9

12 мая 1989 г.

06.3

### ОСОБЕННОСТИ ЖИДКОФАЗНОГО РОСТА $Al_xGa_{1-x}As$ ( $x = 0.2-0.3$ ) ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

А.З. Мереуцэ, А.И. Петров,  
В.М. Полторацкий, В.А. Прокудина,  
А.В. Сырбу, В.П. Тарченко,  
В.П. Яковлев

Низкотемпературная жидкофазная эпитаксия (НЖЭ) в системе  $AlGaAs/GaAs$  (температурный диапазон роста 650-400 °C) позволяет получать многослойные структуры с толщиной слоя порядка единиц нм [1]. Этим методом были изготовлены лазерные диоды с одиночной квантовой ямой с пороговым током генерации 3.5 мА [2]. Одним из дальнейших путей развития НЖЭ в этой системе является разработка методов выращивания структур с многоквантовыми ямами. В связи с этим необходимы данные по низкотемпературному росту  $Al_xGa_{1-x}As$  ( $x = 0.2-0.3$ ), подробные тем, которые были получены для случая  $0 = x$  в работе [3]. Также важным для дальнейшего развития НЖЭ является изучение зависимости параметров слоев  $Al_xGa_{1-x}As$  от переохлаждения раствора-расплава.

В данной работе выращивание  $Al_xGa_{1-x}As$  ( $x = 0.2-0.3$ ) проводилось в графитовых кассетах как слайдового, так и прокачного типа в потоке очищенного водорода с точкой росы -65--80 °C. Толщина слоев определялась в растровом электронном микроскопе на косых шлифах. Проводились измерения длины волны краевой фотолюминесценции выращенных слоев при  $T = 300$  К.

Экспериментальные зависимости толщины слоя  $d$  и длины волны краевой фотолюминесценции  $\lambda$  от переохлаждения раствора-расплава  $\Delta T$  (см. рис. 1) были определены при соблюдении постоянства температуры начала выращивания и времени роста (со-

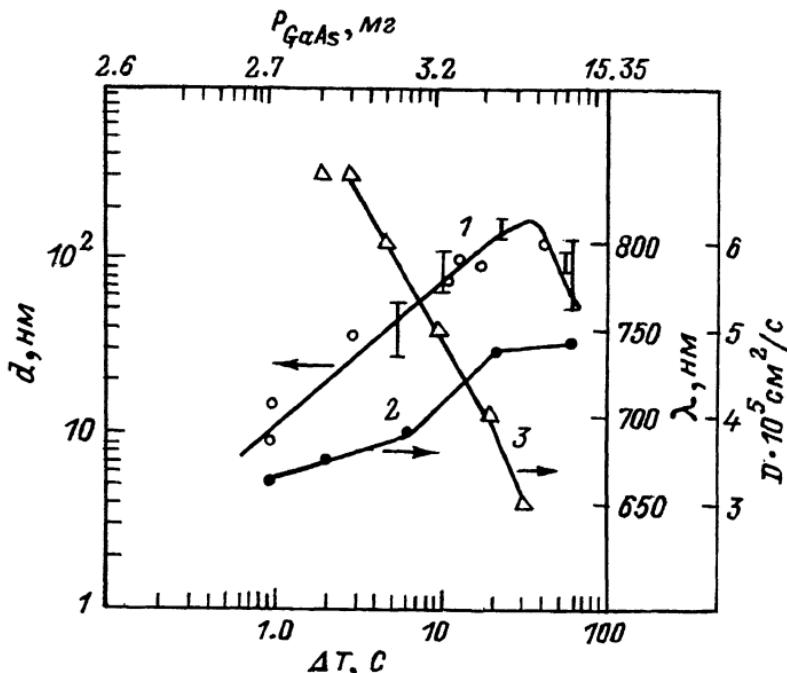


Рис. 1. Зависимости толщины слоя,  $d$  (1), длины волны краевой фотолюминесценции,  $\lambda$  (2) и коэффициента взаимной диффузии растворенного материала  $D$  (3) от переохлаждения раствора-расплава,  $\Delta T$ .

ответственно  $540\text{ }^{\circ}\text{C}$  и  $35\text{ с}$ ). Слои выращивались между двумя слоями широкозонного твердого раствора  $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$  ( $x = 0.7\text{--}0.8$ ). Переохлаждение раствора-расплава варьировалось путем изменения навески арсенида галлия для насыщения жидкой фазы (соответствующие навески  $\text{GaAs}$  на  $1\text{ г}$  галлия приведены на верхней оси абсцисс рис. 1). Толщина слоя раствора-расплава и скорость уменьшения температуры были равны  $2\text{ мм}$  и  $1.5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{мин}$  соответственно. Как видно из рис. 1 (кривая 1), с увеличением переохлаждения толщина слоя увеличивается вплоть до значения  $\Delta T \approx 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ , выше которого  $d$  начинает падать вследствие гомогенного зародышебразования в жидкой фазе. Необходимо отметить, что для традиционной „высокотемпературной“ эпитаксии этого материала критическое переохлаждение равно  $\sim 10\text{ }^{\circ}\text{C}$  [4], что в три раза меньше соответствующего значения для НЖЭ. По-видимому, такое отличие обусловлено очень низкой растворительностью мышьяка в растворе-расплаве для температурного диапазона НЖЭ.

Изменение переохлаждения жидкой фазы приводит к изменению длины волны краевой фотолюминесценции эпитаксиального слоя, (рис. 1, кривая 2). С увеличением  $\Delta T$  от  $1$  до  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$   $\lambda$  увеличивается с наклоном  $4\text{ nm}/^{\circ}\text{C}$ , что соответствует изменению состава  $x$   $0.008\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ . По данным работы [5], изменение  $x$  с переохлаждением для температуры роста  $725\text{ }^{\circ}\text{C}$  составляет  $0.003\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ .

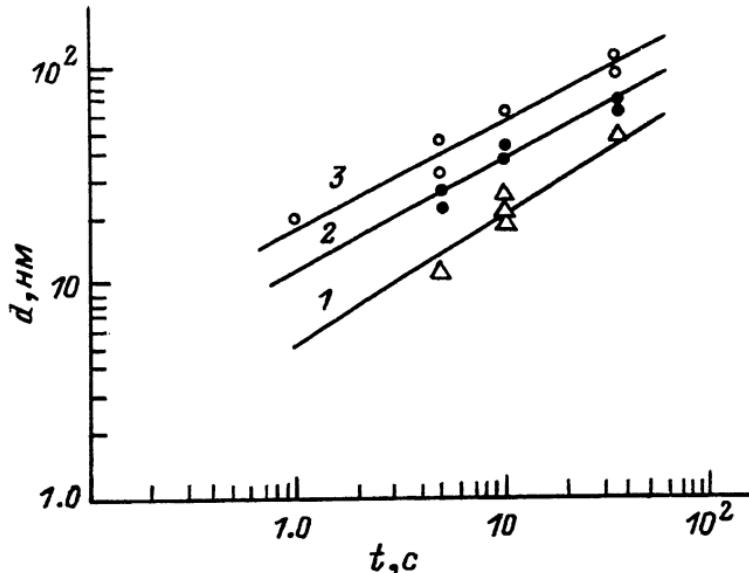


Рис. 2. Зависимости толщины слоя,  $d$ , от времени роста  $t$  для трех значений переохлаждения раствора-расплава  $\Delta T$ : 1 -  $\Delta T = 5^\circ\text{C}$ , 2 -  $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ , 3 -  $\Delta T = 20^\circ\text{C}$ .

На рис. 1 также приведена зависимость коэффициента взаимной диффузии растворенного материала  $D$  от переохлаждения (кривая 3), которая была рассчитана на основе данных зависимости с использованием уравнения для толщины слоя, вырашенного из переохлажденной жидкой фазы [6]. С увеличением переохлаждения от 2 до  $30^\circ\text{C}$  коэффициент диффузии уменьшается от  $6.8 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{s}$  до  $3 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{s}$ . В работах [5, 7] приводится значение коэффициента диффузии для разных температур:  $5 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{s}$  для  $725^\circ\text{C}$  [5],  $1.6 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{s}$  для  $800^\circ\text{C}$  и  $5 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2/\text{s}$  для  $950^\circ\text{C}$  [7]. Следует заметить, что температурная зависимость  $D(T)$ , определенная в [7] для температурного интервала  $800-950^\circ\text{C}$ , при более низких температурах не описывает имеющиеся экспериментальные данные. Помимо этого, в данной работе выявлена зависимость коэффициента взаимной диффузии от переохлаждения, на что ранее не обращалось внимание.

На рис. 2 приведены зависимости толщины слоя от времени роста для трех значений переохлаждения жидкой фазы  $5, 10$  и  $20^\circ\text{C}$ . Зависимости 1, 2 и 3 - расчетные. Необходимые для расчета значения коэффициента диффузии, соответствующие указанным переохлаждениям, были взяты из зависимости  $D(\Delta T)$  (рис. 1, кривая 3). Экспериментальные точки на рис. 2 довольно хорошо соответствуют расчету.

Для получения структур с многоквантовыми ямами, а также для других применений, важно знать, как изменяется состав эпитаксиального слоя с понижением температуры жидкой фазы. Такие данные были получены для начального состава  $x = 0.3$ , интервалов выращивания  $650-500^\circ\text{C}$  (1, рис. 3) и  $580-530^\circ\text{C}$  (2,

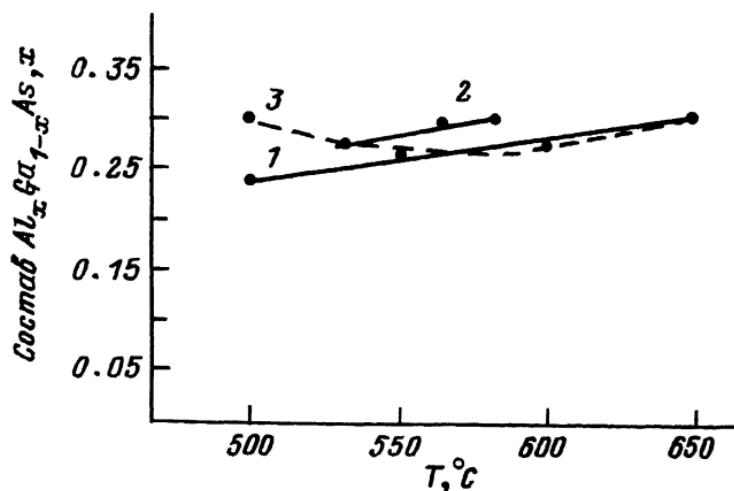


Рис. 3. Изменение состава эпитаксиального слоя  $Al_xGa_{1-x}As$  с начальным составом  $x = 0.3$  при понижении температуры роста  $T$ : 1, 2 - эксперимент; 3 - расчет по данным работы [8].

рис. 3), скорости охлаждения  $1.5^{\circ}\text{C}/\text{мин}$ . Состав твердой фазы для разных температур определяли прерыванием роста при соответствующих температурах и измерением длины волны краевой фотолюминесценции при возбуждении сильно поглощающимся светом  $\lambda = 0.48 \text{ мкм}$ . Зависимость 3 на рис. 3 была рассчитана по данным работы [8] и соответствует равновесной кристаллизации. Как видно из рисунка, в температурном интервале НЖЭ состав слоя  $Al_xGa_{1-x}As$  ( $x \approx 0.3$ ) очень слабо изменяется с температурой. Наблюдается хорошее соответствие с расчетной зависимостью, особенно в интервале температур  $650\text{--}550^{\circ}\text{C}$ .

Ранее в работах [7, 9] указывалось на необходимость учета ассоциации атомов в жидкой фазе  $Al-Ga-As$  при анализе температурной зависимости коэффициента взаимной диффузии и ориентационной зависимости скорости роста. Вероятность ассоциации атомов в комплексы (гетерогенных флюктуаций) в растворе-расплаве экспоненциально увеличивается с понижением температуры по закону  $P = A \exp(-\Delta G/kT)$  [10], где  $A$  - некоторая постоянная,  $\Delta G$  - изменение свободной энергии системы, обусловленное появлением данной флюктуации. Следует ожидать, что ассоциация атомов в жидкой фазе должна иметь существенное проявление в процессе НЖЭ.

Нами была проведена серия опытов по выращиванию  $Al_xGa_{1-x}As$  ( $x = 0.2\text{--}0.3$ ) на планарных и рельефных подложках, ориентированных в плоскостях  $(100)$ ,  $(111)A$  и  $(111)B$ . При температурах начала выращивания ниже  $600^{\circ}\text{C}$  было получено следующее соотношение скоростей роста:  $V_{(100)} > V_{(111)B} > V_{(111)A}$ . Во всех случаях интенсивность фотолюминесценции слоя на  $(111)B$  в 2-3 раза превышала интенсивность на  $(100)$ , а слой на  $(111)A$  практически не люминесцировал. На рельефных подложках не было роста на боковых стенах углублений  $(111)A$ . Изменение соотно-

шения скоростей роста в полярных направлениях  $\langle 111 \rangle$  по сравнению с „высокотемпературной“ эпитаксией [9], а также ухудшение качества слоя (111)А свидетельствует об увеличении вероятности образования комплексов больших размеров типа  $AlAs_nGa_m$  ( $n=1-4$ ,  $m=1-12$ ).

С увеличением переохлаждения насыщенного раствора-расплава уменьшается  $\Delta G$ , что приводит к увеличению степени ассоциации. Дополнительное связывание атомов (в том числе и алюминия) в комплексы является, на наш взгляд, причиной уменьшения  $D$  и  $\alpha$  с увеличением  $\Delta T$ .

В заключение авторы выражают признательность В.М. Андрееву, В.Р. Ларионову и В. Хвостикову за всестороннюю помощь и полезные обсуждения.

#### Список литературы

- [1] Алферов Ж.И., Андреев В.М., Конников С.Г.,  
Ларионов В.Р., Погребицкий К.Ю., Фалеев Н.Н., Хвостиков В.П. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 27. С. 171-175.
- [2] Андреев В.М., Акимов В.Ю., Ларионов В.Р.,  
Румянцев В.Д., Хвостиков В.П. IX Всесоюзная  
конференция по физике полупроводников. Кишинев, 1988. Тезисы  
докладов, т. 2. С. 230-231.
- [3] Алферов Ж.И., Андреев В.М., Воднев А.А.,  
Конников С.Г., Ларионов В.Р., Погребицкий К.Ю.,  
Румянцев В.Д., Хвостиков В.П. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 18. С. 1089-1093.
- [4] Галченков Д.В., Попов В.П., Зотов Л.П. //  
Электронная техника, Материалы. 1987. В. 3. С. 39-41.
- [5] Doi A., Nigao M., Ito R. // Japanese  
J. Appl. Phys. 1978. V. 17. No 3. P. 503-507.
- [6] Кейси Х., Панин М. Лазеры на гетероструктурах.  
М.: Мир, 1981. 362 с.
- [7] Хухранский Ю.П., Пантелеев В.И. // Изв.  
АН СССР, Неорганические материалы. 1981. Т. 17. В.2.  
С. 204-207.
- [8] Елюхин В.А., Карпов С.Ю., Портной Е.Л.,  
Третьяков Д.Н. // Письма в ЖТФ. 1978. Т.4. В. 11.  
С. 629-633.
- [9] Сырбу А.В. Кандидатская диссертация, Кишинев, 1978.  
140 с.
- [10] Медведев С.А. Введение в технологию полупроводнико-  
вых материалов, М.: Высшая школа, 1970. 503 с.

Кишиневский политехнический  
институт им. С. Лазо

Поступило в Редакцию  
2 марта 1989 г.